



2008年3月期 第3四半期資料

2008年2月6日

ワイエイシー株式会社

(証券コード:6298)

<http://www.yac.co.jp>



1. 会社概要



1-1 基本情報

(2007年4月20日現在)

商 号	ワイエイシイ株式会社
証券コード	6298 (東証2部)
設立	1973年(昭和48年)年5月
代表者	代表取締役社長 百瀬武文
事業所等	本 社：東京都昭島市武蔵野3-11-10 営業所：大阪、福岡、大分、昭島、新潟 海 外：台湾支店、上海事務所 工 場：昭島、山梨、熊本
子 会 社	ワイエイシイ新潟精機株式会社 (新潟県妙高市) HYAC Corporation (米国) YAC Systems Singapore Pte Ltd (シンガポール)
資 本 金	2,756百万円
事業内容	産業用エレクトロニクス関連装置、クリーニング関連装置の開発・製造・販売
決 算	3月31日



1-2 当社の主力製品

ハードデスク関連

- ・バニッシャー装置
- ・ワイピング装置
- ・クリーンコンベア

液晶関連

- ・プラズマ・ドライ・エッチング装置
- ・プラズマ・ドライ・アッシング装置
- ・アニール装置

半導体関連

- ・ロジック系IC用テストハンドラー

クリーニング関連

- ・自動包装機
- ・ワイシャツ仕上機
- ・アパレル関連機



主力製品

<ハードディスク関連製品>

バニッシャー	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、表面のナノオーダーの微小突起を除去する精密研磨装置
ワイピング	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、バニッシュ工程の前後で、表面のパーティクルの除去及び潤滑財を表面に均一にする装置
クリーンコンベア (HD工場向け)	モジュールの組み合わせで自由な搬送ライン設計が可能なローラー式コンベアAGV(自走型搬送ロボット)やOHT(天井架設型搬送装置)に比べ、搬送物をいつでも搬送ラインに投入することができ、搬送効率が高い。
クリーンコンベア (半導体工場向け)	(同上)但し、搬送物が300mm用ウエハカセットのため、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、高速搬送が要求される。



バニッシャー



ハードディスク用クリーンコンベア



半導体用クリーンコンベア



主力製品

<液晶関連製品>

プラズマ・ドライ・エッチング装置	液晶ディスプレイの各セルの液晶整列方向を個々に制御する微小トランジスターをガラス基板上に描画するプロセスで用いる。 フォトマスクを通して露光した結果、硬化した部分以外を除去後、露出した薄膜をプラズマを利用してガス化し除去する装置。
アニール装置	ガラス表面に塗布された半導体膜の結晶化と不純物の活性化を行う装置



第7世代用プラズマ・ドライ・エッチング装置(3チャンバータイプ)

対応 基板サイズ
G2
G4
G4.5
G5
G5.5
G6
G7
G7.5
G8



主力製品

<半導体関連製品>

ロジック系IC用
ICテストハンドラー

ICのパッケージング後の検査工程で、テスターと接続して使用し、テスターからのテスト結果信号に基づき、ICを良品と不良品に自動選別する装置。
必要に応じて、精度の高い高温・低温(-55°C~155°C)下でのテストも行う。



ICテストハンドラー(4個同時測定・常温タイプ)

<クリーニング関連製品>

ボディープレス機	シャツを前後から熱版ではさみシャツのボディー部をプレスする装置。 胴立を2つもち、プレス中に次のシャツを装填できるダブルタイプと、胴立がひとつのシングルタイプがある。 またプレス完了のシャツを自動でハンガーの掛けるオートキャリー付のタイプもあり。
タック・スリーブプレス機	シャツのタック部・袖部のプレス機(ダブルタイプ・シングルタイプ)
カラー・カフスプレス機	シャツの襟部・カフス部のプレス機(ダブルタイプ・シングルタイプ)
包装機	クリーニング完了後の衣類にカバーフィルムを自動で装填する装置。 ハンガーのままカバーする立体タイプとたたんだ状態でカバーする平面タイプがある。



シャツ用ボディープレス機
(Wタイプ・オートキャリー付)



包装機 (立体タイプ)



2008年3月期

2. 第3四半期の概要と通期の業績予想



2-1 決算のハイライト(連結)

(単位 百万円)

科目	2006年 3月期 第3四半期	2007年 3月期 第3四半期	2008年 3月期 第3四半期	前年比 増減額	前年比 増減率(%)
売上高	11,852	15,231	16,943	1,712	11.2%
営業利益	1,409	2,098	2,210	112	5.3%
経常利益	1,440	2,015	2,095	80	4.0%
当期利益(四半期)	840	1,322	1,322	0	0.0%
1株当たり当期利益 (四半期)	97.53	138.02	137.02	▲1.0	▲0.7%
営業利益率	11.9%	13.8%	13.0%		



2-2 事業別売上金額(連結)

(単位 百万円)

科目	2006年 3月期 第3四半期	2007年 3月期 第3四半期	2008年 3月期 第3四半期	前年比 増減額	前年比 増減率(%)
メモリーディスク関連	—	6,638	6,062	▲ 576	▲ 8.6%
液晶関連	—	6,443	8,797	2,354	36.5%
半導体関連	—	1,110	580	▲ 530	▲ 47.7%
クリーニング関連	—	1,038	1,503	465	44.7%
合計	11,852	15,231	16,943	1,712	11.2%



2-3 事業別受注・受注残金額(連結)

(単位 百万円)

(1) 受注金額(連結)

科目	2008年 3月期 第3四半期
メモリーディスク関連	4,631
液晶関連	6,221
半導体関連	748
クリーニング関連	(注1)―
合計	11,601

(2) 受注残金額(連結)

2008年 3月期 第3四半期
1,394
7,303
325
(注1)―
9,023

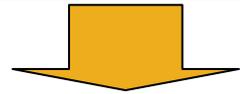
(注1)クリーニング関連は、販売計画に基づいた見込生産を行っておりますので除外しております。



第9次中期計画の基本戦略

I T産業の特徴

1. 高成長 2. 競争激化 3. 高スピード（技術革新） 4. 市場変動（大きい）



この事業環境における安定的収益確保

ワイエイシイの基本戦略

1. 高収益企業への挑戦	<ul style="list-style-type: none">・ オンリーワン技術の強化（差別化）・ 依命システムの徹底・ 低コスト経営の徹底・ モチベーションの一層の高揚
2. マーケット深耕	<ul style="list-style-type: none">・ 顧客との強固な信頼関係構築による市場ニーズの先取りにより新製品バージョンUPによる差別化
3. ファブレス経営の徹底	<ul style="list-style-type: none">・ 営業、開発、技術、アフターサービスを中心とした経営体制・ 市場変動による経営リスクの最小化
4. カスタマー・サポートの充実	<ul style="list-style-type: none">・ 顧客との強固な信頼関係構築による当社純正修理部品の利用推進と消耗品の拡大
5. M&A アライアンス	<ul style="list-style-type: none">・ シェアUPと事業拡大



第9次中期計画の基本戦略

第9次中期計画（平成18年度～20年度）

平成17年8月31日

高収益企業 への挑戦

事業予算の達成

事業部

- ・メモリーディスク
- ・半導体
- ・プラズマシステム
- ・クリーニング

グループ会社

- ・HYAC
- ・YSS
- ・YNS

(1) 事業目標

- ・守りから攻めへの転換(営業利益40億超)
- ・高収益企業への挑戦(営業利益率15%超)
- ・企業価値の向上(時価総額500億円超)
- ・企業ステータスの向上(東証一部上場)

(2) 高収益企業への事業戦略

- ・ソリューション型研究開発企業
- ・マーケット深耕
- ・ファブレス経営
- ・M&A, アライアンス
- ・グローバル経営
- ・やりがい経営

(3) 高収益企業への仕組

オンリーワン技術

- ・製品開発と特許
- ・差別化と顧客密着
- ・プライスリーダー

依命書システム

- ・営業員への粗利依命
- ・製作チームへの粗利依命
- ・デミングサイクルの実践

モチベーションの高揚

- ・部門経営ビジョンの明示
- ・徹底討論
- ・インセンティブ

低コスト経営

- ・少数精鋭集団
- ・変化に即応
- ・事業効率の追求



<ハードディスク市場>

- 動画アプリケーション等の増加による更なる大容量HDの必要性の拡大（書込み方式は垂直からデスクリート媒体へ）
- 携帯音楽プレーヤー、携帯電話、カーナビ、ビデオレコーダー、ビデオカメラ、スチルカメラ、その他各種デジタル家電製品へのHD搭載の拡大（用途拡大が継続し今後とも10%以上成長）
- フラッシュメモリとの競合は限定的で棲み分け(80GB以下フラッシュ)
- 市場の再編により下期が不透明感あり(WDとコマツグの合併等により)

<液晶パネル市場>

- 薄型平面TV普及(液晶が主流)、40～50インチの大型化へ
- 2011年の地上波デジタル放送本格稼働までは積極的な設備投資が継続
- 昨年より有機ELパネルが再度動きはじめた
- 液晶パネル関連の設備投資再開(台湾)



事業環境

<半導体市場>

- 前工程の旺盛な設備投資の拡大
- 後工程は下期以後来年にかけて設備増強が始まると見る

<クリーニング市場>

- 安定市場。消費回復と連動したクリーニング消費拡大の兆し
- 自動化設備投資に積極的な大手店と小規模店の二極化が進行
- 海外販売(米国、ヨーロッパ、中国)拡大



事業別の課題と今後の取組み

事業区分	現 状	課 題	現在・今後取組み
ハードディスク 関連事業	■ バニッシャーでは国内・ 外で約80%のシェア ■ マーケットリーダー	■ バニッシャー市場シェ アの拡大	■ バニッシャー世界シェア 100%を目指す（高スループ ット化、省スペース化）
		■ ワイピング市場シェア の拡大（垂直媒体に対 応）	■ ワイピングシェア100%を 目指す
		■ デスク、半導体・液晶 用コンベアの拡販	■ 海外も含めたコスト低減
		■ 消耗品の拡販	■ 消耗品の拡大 ■ 新テープの開発
液晶関連事業	■ プラズマ・ドライ・エッチン グでは市場シェア25% 程度を確保 （競合は1社のみ）	■ 市場シェアの拡大	■ 競合製品との差別化 オンリーワン技術の確立
		■ 粗利率の向上	■ 徹底したコストダウン ■ 協力会社との連携強化



事業別の課題と今後の取組み

事業区分	現 状	課 題	現在・今後取組み
半導体 関連事業	<ul style="list-style-type: none">■市場シェア5%■特定顧客との関係は強固	<ul style="list-style-type: none">■第2、第3の特定顧客の確保■粗利率の向上	<ul style="list-style-type: none">■特定顧客確保に集中■主要製品のバージョンアップ■新製品の投入<ul style="list-style-type: none">・16個同測ハンドラー・簡易ハンドラー
クリーニング 関連事業	<ul style="list-style-type: none">■業界でのブランド力は強固■包装機国内シェア約90%■仕上機国内シェア約50%	<ul style="list-style-type: none">■シェアアップ■粗利率の向上■海外売上の拡大	<ul style="list-style-type: none">■製品のシステム販売■製販一体化によるコスト低減■米国、中国、ヨーロッパへの拡大



2008年度通期計画(連結)

(単位:百万円)

科目	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期 (計画)		対前年 増減額 (計画)	対前年比 増減率(%) (計画)
				(上期)	(通期)		
売上高	18,711	18,050	22,423	11,500 (12,790)	21,000 [25,000]	▲1,423 [2,577]	▲6.3% [11.5%]
営業利益	1,545	2,495	3,676	1,500 (1,596)	2,400 [3,750]	▲1,276 [74]	▲34.7% [2.0%]
経常利益	1,508	2,401	3,583	1,450 (1,586)	2,400 [3,650]	▲1,183 [67]	▲33.0% [1.8%]
当期純利益	1,197	1,504	2,103	850 (1,038)	1,500 [2,200]	▲603 [97]	▲28.6% [4.6%]
1株当たり当期純利益 (円)	139.4	167.8	219.1	88.1 (107.5)	155.4 [227.9]	▲63.7 [8.8]	▲29.0% [4.0%]

注:()は実績値 []は計画値 \$=105円 S\$=75円



事業別売上金額(連結)

(単位:百万円)

科目	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期 (計画)		対前年 増減額 (計画)	対前年比 増減率(%) (計画)
				(上期)	(通期)		
メモリーディスク関連	4,749	6,811	9,899	4,500 (4,382)	7,500 [10,500]	▲2,399 [601]	▲24.2% [6.1%]
液晶関連	10,919	8,525	9,400	5,500 (6,995)	10,300 [10,600]	900 [1,200]	9.5% [12.8%]
半導体関連	1,365	1,192	1,403	600 (469)	1,000 [1,500]	▲403 [97]	▲28.7% [6.9%]
クリーニング関連	1,678	1,522	1,721	900 (943)	2,200 [2,400]	479 [679]	27.8% [39.5%]
売上合計	18,711	18,050	22,423	11,500 (12,790)	21,000 [25,000]	▲1,423 [2,577]	▲6.3% [11.5%]

注:()は実績値 []は計画値 \$=105円 S\$=75円



2008年度の事業準備（'07年度下期より実施）

1. 2008年度事業予算の策定
2. 予算達成に準備すべき課題
 - ・主力製品のシェア・アップ
 - ・開発製品（主力製品のバージョンアップ、新製品）
 - ・カスタマーサービスの拡大
3. 課題の消化スケジュール
4. 毎月のチェック



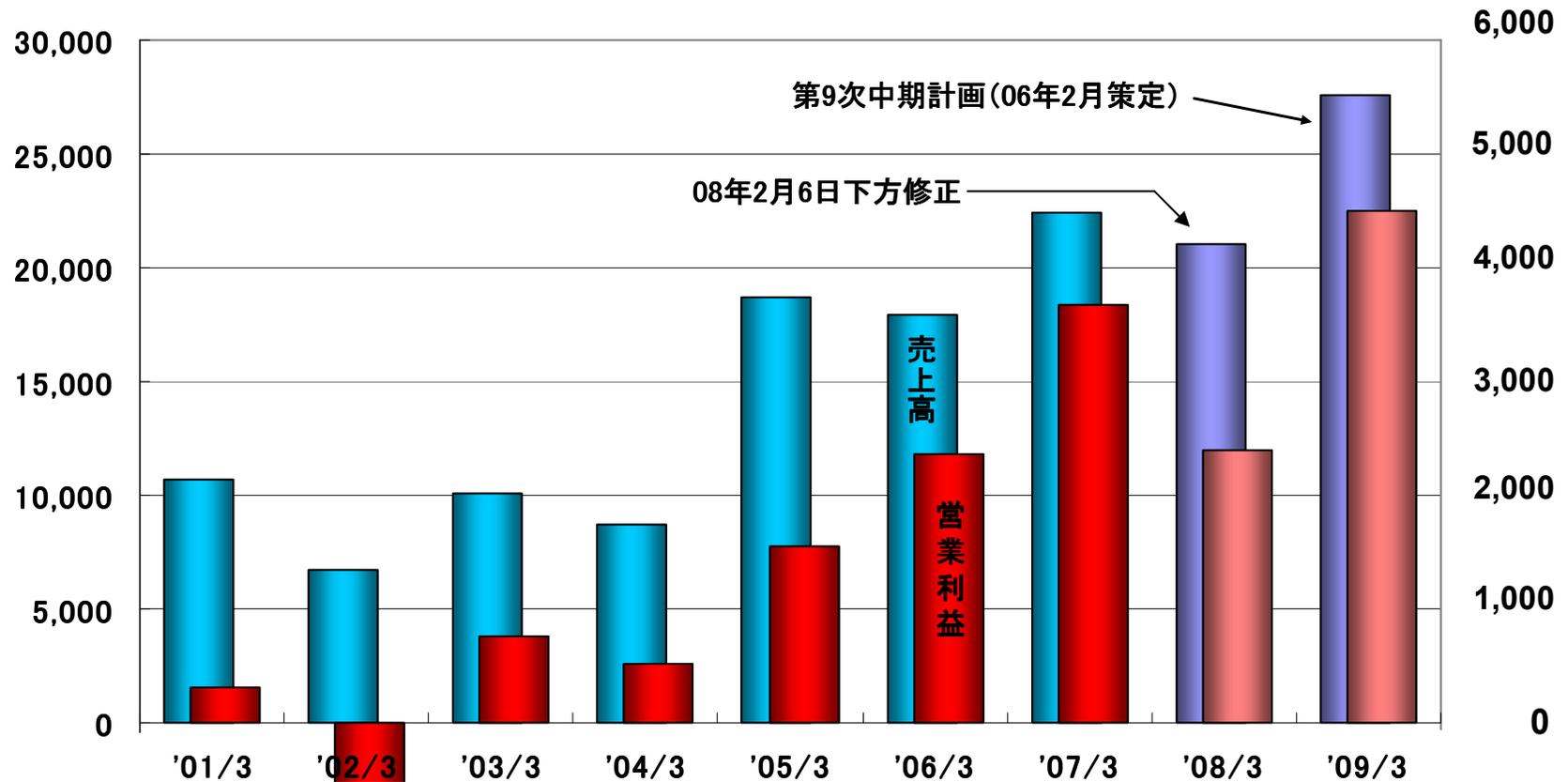
業績推移と第9次中期計画（連結）

売上高

売上・営業利益

(単位:百万円)

営業利益



第7次中期計画

V字回復

第8次中期計画

優良企業復活

第9次中期計画

高収益企業挑戦



業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予数値と異なる可能性があります。

ワイエイシイ株式会社